



一种超薄芯片型热敏电阻的制备方法



孔雯雯; 常爱民



2018-04-13

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要

本发明公开了一种超薄芯片型热敏电阻的制备方法。该方法首先采用流延法制备超薄热敏陶瓷片；继而采用丝网印刷法对陶瓷片进行电极涂覆；接着利用划片机对所得热敏陶瓷芯片进行切割，并在电极表面焊接引线；最后对元件进行超薄绝缘封装。本发明实现了超薄芯片型热敏电阻的制备，该技术具有机械化程度高、工艺简单、成本低廉、普适性强等特点，因此适用于制备各种超薄芯片型电子元器件，具有很大的应用前景。

申请日期 2017-10-31

申请号 CN201711043938.1

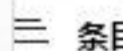
公开(公告)号 CN107910143A

代理机构 乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型 **专利**条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6479>

专题 材料物理与化学研究室

推荐引用方式 孔雯雯,常爱民. 一种超薄芯片型热敏电阻的制备方法. CN107910143A[P]. 2018-04-13. GB/T 7714



条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[\[发表评论/异议/意见\]](#)

暂无评论

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

- ★ 保存到收藏夹
- 👁 查看访问统计
- 📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

- 📖 谷歌学术中相似的文章
- 📖 [孔雯雯]的文章
- 📖 [常爱民]的文章

百度学术

- 📖 百度学术中相似的文章
- 📖 [孔雯雯]的文章
- 📖 [常爱民]的文章

必应学术

- 📖 必应学术中相似的文章
- 📖 [孔雯雯]的文章
- 📖 [常爱民]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享



QQ客服



官方微博



反馈留言